

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Seite/Page
1 / 3

Part Number

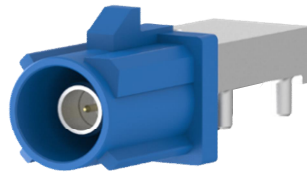
4989.SMBA.1X10.007

Teilenummer

Description

**SMBA (m)
PCB connector SMD Type**

Beschreibung



Design according to

DIN 72594 (FAKRA)

Ausführung nach

Electrical characteristics / Elektrische Eigenschaften

	colored value means: under validation			
		Value/Wert	Unit/Einheit	
Impedance (MIL-C-39012B)		50	[Ω]	Impedanz (MIL-C-39012B)
Operating frequency up to		7,2	[GHz]	Betriebsfrequenz bis zu
Return loss				Rückflusdämpfung
	1 GHz	> 29	[dB]	
	2 GHz	> 26	[dB]	
	4 GHz	> 16	[dB]	
	6 GHz	> 15	[dB]	
	7,2 GHz	> 10	[dB]	
Attention! Electrical values depending on PCB-layout and PCB-material	FR 4	1,5	[mm]	Achtung! Elektrische Werte sind abhängig von Leiterplatten-layout und Material
Insulation resistance		≥ 1	[GΩ]	Isolationswiderstand
Contact resistance				Kontakt-Widerstand
Centre contact		≤ 5	[mΩ]	Innenkontakt
Outer contact		≤ 2,5	[mΩ]	Außenkontakt
Contact current max. (DC)		1	[A] DC	Kontakt-Strombelastbarkeit max (DC)
Operating voltage		Ö60	[V] DC	Betriebsspannung
Proof voltage		500	[V] eff	Prüfspannung

Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften

		Value/ Wert	Unit/Einheit	
Engagement force		< 25	[N]	Steckkraft
Separating force		< 25	[N]	Ziehkraft
Mating cycles		> 25		Steckzyklen
Retention force (with latch)		> 100	[N]	Haltekraft (mit Verriegelung)
Weight		~ 2,53	[g]	Gewicht

Date/Generated: 10.02.2023 / lfa

Revision

e

Date/Approved: 10.02.2023 / F.Fung

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Page/Seite
2 / 3

Part Number	4989.SMBA.1X10.007	Teilenummer
Description	SMBA (m) PCB connector SMD Type	Beschreibung

Material & plating / Material & Oberfläche

RoHS (2002/95/EC) conform			
	Material/Material	Plating/Oberflächen	
Plastic housing	PA 4.6	-	Kunststoffgehäuse
Centre contact	Brass	Ni-P + 0,15µm Au	Innenkontakt
Insulator	SPS	-	Isolator
Housing	Diecast	3-5 µm Ni + 2-4 µm Sn	Gehäuse

Environmental influences		Umwelteinflüsse
Operating temperature range	-40°C up to +105°C	Betriebstemperaturbereich
	Standard	
Climatic sequence:	IEC 60068-2-61	Klimafolge:
1. Dry heat	IEC 60068-2-2-Ba	1. Trockene Hitze
2. Damp heat, cyclic, 1 cycle	IEC 60068-2-30-Db	2. Feuchte Wärme, zyklisch, 1 Zyklus
3. Cold	IEC 60068-2-1-Aa	3. Kälte
4. Damp heat, cyclic, 6 cycles	IEC 60068-2-30-Dd	4. Feuchte Wärme, zyklisch, 6 Zyklen
Solder profile	JEDEC J-STD-020E	Lötprofil

Notes	Aufzeichnungen
--------------	-----------------------

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Update History

Rev.	Date	Signature	Alteration	Approved
a	31.01.2013	lhen	HF Update	
b	21.03.2013	lhen	Plating Updates	
c	26.01.2016	MF	EC_006_16	F.Fung, M.Bleich
d	25.02.2019	lfa	revised	
e	10.02.2023	lfa	revised	
				Formblatt-Nr.: Form-TK-013ab
				Rev. 04
				Released 17. Apr 14

Date/Generated: 10.02.2023 / lfa Revision e
Date/Approved: 10.02.2023 / F.Fung

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Seite/Page
 3 / 3

Part Number

4989.SMBA.1X10.00Z

Teilenummer

Description

**SMBA (m)
 PCB connector SMD Type**

Beschreibung

Soldering process / Lötprozess

**Soldering methode /
 Lötmethode:**

THR / Reflow

**Recommended reflow soldering profil /
 Empfohlenes reflow Lötprofil:**

Parameter	Reference	Specification
Max. Temperature (lead free soldering) Max. Temperatur (bleifreies Löten)	C°	260°

